

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 4 月 16 日 (2009.4.16)

【公表番号】特表 2008-536296 (P2008-536296A)

【公表日】平成 20 年 9 月 4 日 (2008.9.4)

【年通号数】公開・登録公報 2008-035

【出願番号】特願 2008-500764 (P2008-500764)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

H 0 1 L 21/3213 (2006.01)

H 0 1 L 21/306 (2006.01)

C 2 3 F 1/00 (2006.01)

C 2 3 F 4/00 (2006.01)

C 2 3 C 8/36 (2006.01)

C 2 3 C 8/10 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/302 1 0 4 C

H 0 1 L 21/88 C

H 0 1 L 21/306 F

C 2 3 F 1/00 1 0 1

C 2 3 F 4/00 A

C 2 3 C 8/36

C 2 3 C 8/10

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 2 月 10 日 (2009.2.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 0】

銅層をエッチングする方法であって、

プラズマ室内で摂氏約 200 度を越える温度で第 1 のプラズマによって前記銅層の少なくとも一部を酸化し、

前記銅層の前記酸化部分を実質的に除去し、約 10 nm 未満の平均表面粗さを有する残存表面を露出させるために、前記プラズマ室内で摂氏約 100 度未満の温度で第 2 のプラズマによって前記銅層をエッチングする、こと、

を備える方法。